

Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

[HEAVY COPPER BOARD Hersteller China](#)

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

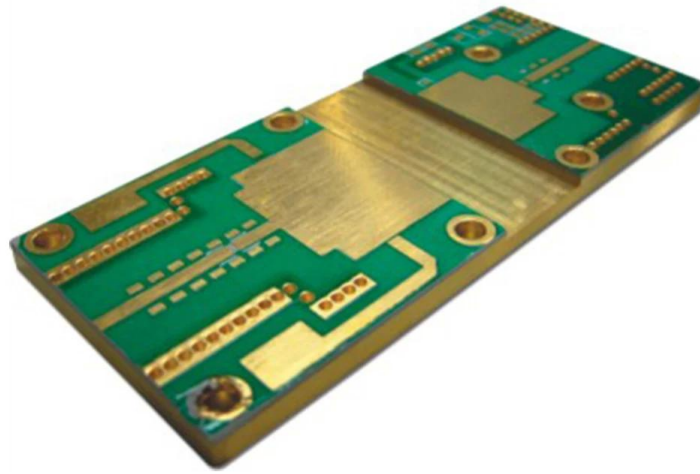
Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [PCB mit Kupferfüllung Großhandel](#)

Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|--|
| PCB P / N. | Q508756-C |
| Ebenenanzahl | 2L |
| Material | Basiskeramik |
| Board thk | 0.50mm |
| Kupfer thk | 1 / 1oz |
| Kleinste Lochgröße | 1,6 mm |
| Anzahl der Löcher (Stk.) | 4 |
| Linie w / s | 1.27mm |
| ichmPedanzkontrolle. J / N (Tol%) | N. |
| Oberflächenveredelung | ENIG |
| Lötmaske Siebdruck | N / A |
| Einzelplatinengröße | Dim X (mm): 50; Dim Y (mm): 55 |
| Panelisierung | D.im X (mm): 50; Dim Y (mm): 55; Anzahl der USV: 1 |
| Besonderheit: abziehbare Maske | N. |
| Routing / Stanzen | CNC. |

•



www.o-leading.com

[Kupferbasierter Leiterplattenhersteller China](#)

FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → innerer Trockenfilm → inneres Ätzen → innerer AOI → Mehrfachbindung → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → äußeres Ätzen → äußerer AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.

Unser Team



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Zertifizierungen

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
Credit No: 61691591-000-07-18-7
Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK
Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| First supervision and audit | Second supervision and audit | Qualified mark |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be restricted to those activities which are covered by the certification. The actual information of this certification can be searched on the internet of CICC www.cicc.com.cn. For the sake of clarity see also the note.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书
证书号: 18118Q10347R05

兹证明
诚领供应链（香港）有限公司
统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7
注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室
经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

| | | |
|-------|-------|-----|
| 第一次监督 | 第二次监督 | 黏贴处 |
|-------|-------|-----|

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

| Type | Cond Width | | | SS/ DS/ DSO | Max | Max | | Meets UL796 | C T | |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|------|-------|----------------|--------|-------|
| | Min | Cond | Area | | Solder | Oper | Flame | | | |
| | mm(in) | Edge Thk | Diam | | Limits | Temp | | | | Class |
| Multilayer (mass laminate) printed wiring boards. | | | | | | | | | | |
| O-LEADING-401 | 0.1 (0.004) | 0.3 (0.012) | 34 (1.34) | DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 | - |
| O-LEADING-407 | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) | 17 (0.67) | DS | 9.7 (0.4) | 260 | 10 | 130 | V-0 | All |
| Multilayer printed wiring boards. | | | | | | | | | | |
| O-LEADING-408 | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) Int:136 | DS | 50.8 (2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 | All * |
| Single layer printed wiring boards. | | | | | | | | | | |
| O-LEADING-002 | 0.38 (0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) | SS | 19.1 (0.8) | 260 | 10 | 105 | V-0 | All - |
| O-LEADING-003 | 0.38 (0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) | SS | 19.1 (0.8) | 260 | 10 | 130 | V-0 | ▲ - |
| O-LEADING-033 | 0.15 (0.006) | 0.3 (0.012) | 34 (1.34) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 | All - |
| O-LEADING-205 | 0.1 (0.004) | 0.3 (0.012) | 34 (1.34) | DS | 69.6 (2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | All - |
| O-LEADING-206 | 0.15 (0.006) | 0.33 (0.013) | 17 (0.67) | DS | 69.6 (2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | All - |
| O-LEADING-D01 | 0.14 (0.006) | 0.15 (0.006) | 33 (1.30) | DS | 25.4 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | All * |
| O-LEADING-S01 | 0.25 (0.010) | 0.25 (0.010) | 17 (0.67) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | V-0 | All * |

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|----|------------|-----|---|-----|-----|-------|
| O-LEADING-S02 | 0.2 (0.008) | 0.2 (0.008) | 17 (0.67) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | HB | ▲ * |
| O-LEADING-S03 | 0.25 (0.010) | 0.25 (0.010) | 34 (1.34) | SS | 25.4 (1.0) | 260 | 4 | 130 | V-0 | All * |

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



| Quick Turn Lead Time | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| Layer Count: | Lead Tim | Special Requirement |
| 1L/2L | 2-3days | 24 Hours,48 Hours |
| 4L | 3-4days | 48 Hours |
| 6L | 4-5days | 72 Hours |
| 8L | 5-6days | NA |
| 10L | 6-7days | NA |
| 12L | 7-8days | NA |
| 14L | 8-9days | NA |

| Standard Lead Time | | |
|--------------------|------------------|------------------------|
| Layer Count: | Sample Lead Time | Volume order lead time |
| 2L | 4 days | 10 days |
| 4L | 5 days | 11 days |
| 6L | 6 days | 12 days |
| 8L | 8 days | 14 days |
| 10L | 10 days | 16 days |
| 12L | 12 days | 18 days |
| 14L | 14 days | 20 days |
| 16-32L | 18 days | 24 days |

Prozessfähigkeit

Produktionsmöglichkeiten für Leiterplatten

Layer Count: 1Layer-32Layer

Fertige Kupferdicke: 1 / 3oz-12oz

Min. Linienbreite / Abstand innen: 3,0 mil / 3,0 mil

Min. Linienbreite / Abstand außen: 4,0 mil / 4,0 mil

Maximales Seitenverhältnis: 10: 1

Plattendicke: 0,2 mm - 5,0 mm

Maximale Panelgröße (Zoll): 635 * 1500 mm

Minimale Bohrlochgröße: 4mil

Plated Hole Tolerance: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All-Typen): JA

Über Füllung (leitend, nicht leitend): JA

Basismaterial: FR-4, FR-4High Tg.Halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid,
Schweres Kupfer

Oberflächen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Silbersilber,Immersion Tin, Goldfinger, Carbon Tinte

SMT-Produktionskapazitäten

Leiterplattenmaterial: FR-4, CEM-1, CEM-3, Leiterplatte auf Aluminiumbasis
Maximale Leiterplattengröße: 510 x 460 mm
Min. Leiterplattengröße: 50x50mm
Leiterplattendicke: 0,5 mm - 4,5 mm
Plattendicke: 0,5-4 mm
Min. Komponentengröße: 0201
Standard-Chipgrößenkomponente: 0603 und größer
Maximale Höhe der Komponente: 15 mm
Minimaler Steigungsabstand: 0,3 mm
Min. BGA-Ballabstand: 0,4 mm
Platzierungsgenauigkeit: +/- 0,03 mm